

## 概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此為概要，其並不包含可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下在決定[編纂][編纂]前應閱讀整份文件。任何[編纂]均涉及風險。[編纂][編纂]的部分特定風險載列於本文件「風險因素」一節。閣下在決定[編纂][編纂]前應仔細閱讀該節。

### 概覽

#### 我們的定位

我們是世界領先的微納米製造解決方案供應商之一，提供全面的產品組合，主要涵蓋微機電系統（「MEMS」）微納米製造元件、半導體測試探針及微型傳動系統。我們致力於以一站式微納米製造解決方案賦能全球客戶，並成為世界級創新推動者。我們的歷史可追溯至2012年6月本公司成立之時。根據弗若斯特沙利文數據，以2025年的收入計，我們在全球MEMS聲學模組微納米製造元件市場中排名第二，市場份額為12.4%；在全球半導體最終測試（「FT」）探針市場，我們在中國境內企業中排名第一，在全球所有供應商中排名第四，市場份額為6.6%。於最後實際可行日期，我們是中國境內少數向海外市場出口半導體最終測試探針的領先企業之一，亦是中國境內首家實現同軸探針大規模生產的企業。

我們設計及製造用於半導體及先進製造業的高精度微米級元件及系統。我們的主要產品包括：(i) MEMS微納米製造元件，其為微型化結構裝置，包括用於聲學及壓力傳感器的屏蔽蓋、微機械結構及微型連接器。我們的MEMS元件集成於智能手機、AR/VR頭戴式設備、醫療助聽器及藍牙揚聲器中，用於語音捕捉、噪音控制及氣壓感測；(ii) 半導體測試探針，其為關鍵消耗品，在設計驗證、晶圓級測試及封裝後測試期間形成測試設備與芯片之間的電氣連接。我們的探針用於測試驅動5G智能手機及AI／數據中心計算的邏輯、存儲器、模擬、電源及射頻器件；及(iii) 微型傳動系統，其為精密機械組件，包括微電機、齒輪及相關部件，可在緊湊空間內實現動力傳輸及運動轉換。我們的微型傳動系統用作需要靜音運行、耐用性及精確運動控制的家用機器人及智能家電中的傳動裝置。

憑藉客戶導向的研發文化，我們通過與客戶聯合研發，將產品設計與終端應用場景相融合，成功進入領先消費電子及半導體企業的核心供應鏈，並將業務拓展至AI、高性能計算、機器人及5G等下游應用領域。我們服務於消費電子、半導體及醫療設備領域的國際品牌，合作模式以聯合研發為基礎，並為每個重點客戶配備專屬跨職能團隊，從早期設計階段到認證及產能提升階段，全程配合客戶的技術路線圖。此模式不僅提高了客戶粘性，將我們的專有技術融入客戶解決方案，亦提升了行業進入壁壘。

#### 我們的表現

於往績記錄期間，我們實現了強勁增長。我們的收入由2023年的人民幣285.5百萬元增加至2024年的人民幣567.9百萬元，並進一步增加至2025年的人民幣864.2百萬元。

## 概 要

下文載列我們歷年的主要業績：

### 領先的市場地位



#### 位列全球第二

2025年在MEMS聲學模組微納米製造元件市場，按收入計



#### 位列全球第四、中國第一

2025年，在全球半導體最終測試探針市場按收入計



#### 首家中國內地公司

實現同軸探針大規模量產

### 廣泛的市場覆蓋範圍



#### 市場滲透

截至最後可行日期，就2025年的出貨量而言，產品供應給全球10大智能手機品牌中的七家



#### 少數中國內地公司之一

截至最後可行日期，是首家向海外市場出口半導體最終測試探針的中國內地公司



#### 國際市場覆蓋

截至最後可行日期，產品銷往約22個海外國家和地區

### 出色的財務表現



#### 人民幣864.2百萬元

2025年收入



#### 複合年增長率74.0%

2023年至2025年的收入



#### 超50%

2025年出口量較2024年實現同比增長

## 我們的產品

我們提供三大類主要產品：(i)MEMS微納米製造元件；(ii)半導體測試探針；及(iii)微型傳動系統。下文說明截至最後實際可行日期我們三個類別的多元化產品組合。



## 概 要

- MEMS微納米製造元件方面，我們是國際領先品牌的認可供應商，深度參與其全球供應鏈。我們的MEMS微納米製造元件乃按客戶規格進行定製。我們的產品組合包括：(i)電磁干擾(「EMI」)屏蔽罩，可用於隔離磁干擾及散熱，保護智能手機攝像頭模組、聲學元件及光學鏡頭中的芯片及其他器件；(ii)精密結構件，可用於保護內部元件、實現熱管理及固定功能，並在有限空間內整合功能模組；(iii)微型連接器及相關部件，可提供電氣及聲學連接，實現信號及數據傳輸。

我們的MEMS微納米製造元件廣泛應用於主流消費電子產品。根據弗若斯特沙利文數據，截至最後實際可行日期，按2025年出貨量計，全球十大智能手機品牌中有七家的智能手機產品已採用我們的產品。我們亦服務於醫療設備等下游領域，該等領域通常具有更高的利潤率及良好的增長前景。

- 半導體測試方面，我們提供：(i)用於封裝後端測試的最終測試探針及測試座；(ii)用於切割前晶圓分選的芯片探測(「CP」)探針及探針卡；及(iii)用於高密度互連(「HDI」)及集成電路(「IC」)基板的基板級測試針。我們正拓展產品線，推出MEMS工藝CP探針及基板級微間距解決方案，以滿足先進技術節點及更高測試密度的需求。我們設計並開發客戶定製產品，以滿足晶圓級及晶片級測試需求。若干子組件(如探針、夾蓋及熱管理結構)以模組化形式實現標準化，可通過不同組合進行配置及集成，從而按客戶規格交付最終產品。

我們已通過服務AI、汽車及消費電子終端市場的頂尖國際半導體設計商及製造商的認證，證明我們具備大規模供應高可靠性產品並實現具有競爭力良率的能力。

- 微型傳動系統方面，我們為機器人及智能設備研發高強度塑膠齒輪、齒輪組及相關總成。我們的微型傳動系統乃按客戶規格進行定製。我們初期以清潔機器人為目標市場，並已將業務拓展至無人機及其他消費級機器人平台等應用領域。針對清潔機器人，我們正研發精密變速箱總成，預期該產品日後將成為我們收入的重要來源。我們與全球領先無人機製造商合作，正開發用於雲台及飛控組件的輕量化微型傳動系統。截至最後實際可行日期，我們已完成工程與設計驗證構建，並啟動客戶認證所需的試產運行。

## 市場機遇

我們所處市場增長迅速且潛力巨大。我們相信，我們的終端市場受益於多項結構性增長驅動因素，包括：

- MEMS微納米製造元件*。MEMS傳感器持續向消費、汽車、工業、醫療及通信市場滲透。AI與物聯網的融合不斷提高對傳感器精度、智能化及密度的要求。在AI

---

## 概 要

---

應用中，更嚴格的數據採集規格使MEMS傳感器成為關鍵基礎硬件層；在物聯網（「IoT」）部署中，系統複雜性及節點數量的增加推動每台設備的傳感器含量提升。該等趨勢預期將支持MEMS精密元件及相關微納米製造解決方案的需求持續增長。

- **半導體測試探針。** AI計算的快速發展推動半導體測試的數量及複雜性不斷提升。AI處理器出貨量的增長預期將帶動前端CP及後端最終測試領域半導體測試探針的需求增加。與此同時，工藝節點遷移及更複雜的器件架構提高了測試強度及技術要求（更細的間距、更嚴的平面度及更嚴格的熱控制），進而提升每個探針的價值。

先進封裝（尤其是芯粒架構）正快速發展。將大型系統單芯片（「SoC」）分解為多個芯粒，需要在芯粒階段進行全晶片級篩選以保障良率，這將大幅增加探針、探針卡及相關測試設備的消耗。隨著芯粒解決方案從2D向2.5D及3D集成發展，測試密度及複雜性持續提升，微間距、高可靠性探針的目標市場不斷擴大，有利於我們半導體測試探針產品的產能提升。

- **微型傳動系統。** 機器人及智能設備領域的新興應用為微型傳動系統創造了新需求。掃地機器人市場的增長，以及下一代人形及自主平台應用場景的預期拓展，均提高了對高強度微型齒輪、齒輪組及緊湊型變速箱的需求。

### 全球戰略及前景

我們正實施全球戰略，以獲取頂尖工程人才、緊密聯繫核心客戶並提升供應鏈韌性。於往績記錄期間，我們主要依靠中國內地的資源，特別是研發與製造能力，支持海外業務，同時充分利用各子公司於不同市場的獨特地域優勢。作為全球戰略的一部分，我們已在關鍵市場成立具備研發及商業職能的專門子公司。我們已在日本、瑞士、美國及新加坡設立子公司，形成覆蓋研發、生產及銷售的網絡。我們的日本子公司專注於探針卡設計及驗證，瑞士子公司則研發超高精度自動化設備；美國子公司服務北美地區客戶，新加坡子公司則作為東南亞市場樞紐。憑藉這一全球佈局，我們旨在縮短交貨週期、加強現場支持、加快客戶認證，同時深化與現有藍籌客戶的合作關係，提高在該等客戶中的業務份額。詳情請參閱「業務—概覽」。

### 我們的業務模式

我們提供為客戶需求量身定製的端到端微納米製造解決方案。我們按客戶規格進行設計及生產，將設計支持、原型製作、試生產、量產、包裝及測試一站式整合，使客戶能與單一合作夥伴合作，從概念階段推進至合格量產階段。

---

## 概 要

---

我們的產品高度定製化，其設計、結構、尺寸及性能參數均根據個別客戶及終端品牌原始設備製造商（「OEM」）的需求定製。因此，我們主要與零部件及終端產品製造商合作，聯合設計及研發產品。在大多數情況下，我們派遣工程師與模組製造商或終端客戶共同參與前端設計，確定技術規格及生產計劃；經過內部及客戶審核後，我們開展模具製作及試生產，並在客戶確認試產批次合格後開始批量供應。在其他情況下，客戶提供圖紙或設計要求，我們評估初始設計，與客戶商討擬議修改方案，確認最終設計及生產計劃後，開展模具設計及試生產；待客戶確認試產合格後，轉入量產。

通過在產品設計的最初階段參與，我們能全面了解客戶的戰略目標及終端產品開發藍圖。憑藉這些洞察，我們利用行業領先的微納製造能力，提供與客戶需求高度契合的產品。

### 我們的產品

我們已研發出全面的產品組合，主要涵蓋MEMS微納米製造元件、半導體測試探針及微型傳動系統。我們的MEMS微納米製造元件銷售予MEMS傳感器製造商，主要用於聲學及壓力傳感。我們的半導體測試探針由主要芯片製造商及獨立半導體測試服務提供商採購，它們是封裝及測試環節的關鍵消耗品；微型傳動系統則供應予清潔機器人OEM廠商。

我們的產品廣泛應用於半導體製造與電子產品生產、汽車電子、安防監控、消費電子與智能設備、工業與物聯網、醫療設備等領域。EMI屏蔽罩應用於消費電子及安防應用中的MEMS傳感器配合使用。精密結構件應用於智能手機及車載攝像頭模組。精密連接器則應用於智能手機、平板電腦及可穿戴裝置（如TWS耳機及智能手錶）的電力、信號及數據傳輸。塑膠插座應用於移動及消費類SoC、電源管理IC、存儲器、汽車微控制器及傳感器的生產測試及老化測試。MEMS探針卡應用於慣性傳感器、磁力計、氣壓與壓力傳感器及流量傳感器的晶圓級測試。齒輪箱組件則應用於智能清潔機器人及其他智慧家居設備。

## 概 要

下表載列於往績記錄期間主要產品線的銷售量、平均售價及價格範圍。

	截至12月31日止年度								
	2023年			2024年			2025年		
	銷量	平均售價 <sup>(1)</sup>	價格範圍	銷量	平均售價 <sup>(1)</sup>	價格範圍	銷量	平均售價 <sup>(1)</sup>	價格範圍
(千件)	(人民幣元)	(人民幣元)	(千件)	(人民幣元)	(人民幣元)	(千件)	(人民幣元)	(人民幣元)	
<b>MEMS微納米製造元件</b>									
—EMI屏蔽罩 .....	1,323,609	0.1	0.02-3,710.92	1,602,622	0.1	0.02-270.00	1,606,221	0.1	0.0001-1,490.00
—精密結構件 .....	98,845	1.0	0.07-51,327.43	116,888	0.8	0.07-38,495.6	199,302	0.9	0.04-80,000.00
—精密連接器 .....	18,151	0.5	0.07-1,635.39	67,642	0.2	0.03-10,800.00	25,880	0.4	0.07-9,060.00
小計 .....	<u>1,440,605</u>	<u>0.1</u>		<u>1,787,153</u>	<u>0.1</u>		<u>1,831,403</u>	<u>0.2</u>	
<b>半導體測試探針</b>									
—銷釘 .....	7,899	6.2	0.43-585.08	11,167	4.8	0.35-468.57	12,785	6.3	0.57-239.13
—塑膠插座 .....	2	3,239.1	66.00-85,000.00	6	7,618.9	4.50-124,044.48	7	21,589.2	144.18-152,217.70
—其他半導體測試探針 .....	284	5.3	3.54-5,000.00	332	53.5	1.22-38,259.87	851	28.2	1.12-68,141.59
小計 .....	<u>8,185</u>	<u>7.1</u>		<u>11,167</u>	<u>4.8</u>		<u>13,626</u>	<u>19.0</u>	
微型傳動系統 .....	<u>2,158</u>	<u>1.9</u>	<u>0.18-653.31</u>	<u>21,642</u>	<u>7.1</u>	<u>0.18-161.05</u>	<u>10,656</u>	<u>17.4</u>	<u>0.19-2,477.88</u>
總計 .....	<u><u>1,450,948</u></u>			<u><u>1,820,300</u></u>			<u><u>1,855,685</u></u>		

附註：

(1) 平均售價是通過將同年收入除以相應銷售量計算得出。

詳情請參閱「業務 — 我們的產品」。

### 我們的競爭優勢

我們相信，以下競爭優勢可支持我們實現可持續增長：(i)憑藉先進的微納米製造能力奠定市場領導地位；(ii)深度融入藍籌客戶業務流程，響應迅速，客戶留存率高；(iii)研發至生產一體化，實現高效商業化及可擴展產能；(iv)嚴格的質量控制，確保大規模量產的穩定性；及(v)經驗豐富的管理團隊及嚴謹的執行力，支持長期增長。詳情請參閱「業務 — 我們的競爭優勢」。

### 我們的戰略

我們擬憑藉現有優勢，實施以下戰略，以把握不斷增長的市場機遇、進一步鞏固市場地位並實現我們的使命：(i)加快技術創新及研發，保持技術領先地位；(ii)與領先客戶開展

## 概 要

聯合研發，加強客戶合作；及(iii)拓展我們的海外佈局，以提升國際業務覆蓋範圍及市場份額。詳情請參閱「業務—我們的戰略」。

### 製造

#### 生產設施

我們的製造工廠位於中國蘇州，總建築面積為約34,564.9平方米。下表載列於所示年度我們製造工廠按生產線劃分的產能、產量及產能利用率。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	(百萬個，百分比除外)		
<b>產能<sup>(1)</sup></b>			
— MEMS微納米製造元件 .....	2,585.1	2,678.3	2,726.1
— 半導體測試探針 .....	27.5	36.6	48.2
— 微型傳動系統 .....	2.8	14.1	16.8
<b>產量</b>			
— MEMS微納米製造元件 .....	1,442.5	1,803.1	1,834.9
— 半導體測試探針 .....	8.5	15.7	27.2
— 微型傳動系統 .....	0.2	5.7	7.2
<b>產能利用率<sup>(2)</sup></b>			
— MEMS微納米製造元件 .....	55.8%	67.3%	67.3%
— 半導體測試探針 .....	30.9%	42.8%	56.5%
— 微型傳動系統 .....	8.6%	40.4%	42.6%

附註：

(1) 在旺季，我們的生產設施可增加運作天數以滿足採購訂單之交付時間表，在此情況下實際產量或會超出該等設計產能。我們的產能乃基於以下假設計算：(i)生產線正滿負荷運作；(ii)生產線每日運作24小時；(iii)生產線每月運作26日；及(iv)生產線全年運作。

(2) 按某一年度的產量除以同年產能計算。

### 我們的客戶及供應商

#### 我們的客戶

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括(i)MEMS傳感器製造商、(ii)主要芯片製造商及(iii)獨立半導體測試服務提供商。於2023年、2024年及2025年，我們分別約76.2%、75.8%及70.6%的總收入來自中國(包括香港及台灣)；而同年分別約23.8%、24.2%及29.4%的總收入來自海外司法權區(包括北美洲、歐洲及亞洲其他國家及地區)。於2023年、2024年及2025年各年，我們的五大客戶合共分別貢獻人民幣133.9百萬元、人民幣310.1百萬元及人民幣456.0百萬元

## 概 要

的收入，分別佔我們總收入的約46.9%、54.6%及52.8%。此外，於2023年、2024年及2025年各年，來自我們最大客戶的收入分別佔我們總收入的約13.2%、25.4%及18.0%。於往績記錄期間各年度，我們的五大客戶均為獨立第三方。據本公司董事所知，於往績記錄期間各年度，本公司任何董事、其各自聯繫人或任何持有本公司已發行股本超過5%的股東，均未在我們的任何五大客戶中擁有任何權益。詳情請參閱「業務—我們的客戶」。

### 我們的供應商

我們產品的核心原材料包括不鏽鋼、鎳鐵合金及塑料顆粒。於往績記錄期間，我們的供應商主要包括原材料供應商及若干加工服務提供商。在2023年、2024年及2025年各年，來自我們五大供應商的採購額分別為人民幣41.7百萬元、人民幣102.4百萬元及人民幣103.9百萬元，分別佔我們採購總額的約26.1%、27.8%及20.2%。此外，在2023年、2024年及2025年各年，來自我們最大供應商的採購額分別佔我們總採購額的約7.3%、7.0%及5.8%。於往績記錄期間各年度，我們的五大供應商均為獨立第三方。據本公司董事所知，於往績記錄期間各年度，本公司任何董事、其各自聯繫人或任何持有本公司已發行股本超過5%的股東，均未在我們的任何五大供應商中擁有任何權益。詳情請參閱「業務—我們的供應商」。

### 風險因素

我們的業務面臨多項風險，包括載於標題為「風險因素」章節內的風險。由於不同投資者在判斷風險重要性時可能有不同的理解及判斷標準，閣下在決定[編纂]我們的[編纂]前，應完整閱讀「風險因素」章節。我們面臨的部分主要風險包括：(i)微納米製造行業競爭激烈且發展迅速。若我們無法與現有或新興競爭者展開有效競爭，我們的銷售額、市場份額及盈利能力可能會受到不利影響；(ii)我們未來的成功取決於能否及時研發、推出、市場推廣及銷售新產品，而我們未必能實現這一目標。此外，研發更複雜的新產品及新技術亦可能增加我們的銷售成本，並對我們的毛利率造成不利影響；(iii)我們的研發項目可能無法跟上技術的快速變革及行業標準的不斷演進，這可能導致我們的產品及技術失去競爭力或過時，進而使我們的產品需求下降，並可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響；(iv)我們的收入很大一部分來自少數幾名客戶。若失去一名或多名該等客戶，或該等客戶的採購量大幅減少，均可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；及(v)我們的過往財務表現可能無法代表未來表現。我們於往績記錄期間錄得經營虧損及淨虧損，未來未必能夠維持收入增長並實現盈利。詳情請參閱「風險因素」。

### 我們的控股股東

於最後實際可行日期，駱先生及蘇州和陽(由駱先生以普通合夥人身份控制)共同控制本公司已發行股本總額約38.04%所對應的表決權，具體包括：(i)駱先生直接持有約33.33%的表決權；及(ii)蘇州和陽直接控制約4.71%的表決權。假設[編纂]未獲行使，則[編纂]完成後即時，駱先生及蘇州和陽將共同控制本公司經擴大已發行股本總額約[編纂]%所對應的表決權。因此，於[編纂]後根據上市規則而言，駱先生及蘇州和陽將被視為本公司的控股股東集團。

## 概 要

詳情請參閱「與我們的控股股東的關係」。

### 歷史財務資料概要

下表載列我們於往績記錄期間的綜合財務資料中的若干選取項目，該等項目摘錄自本文件附錄一所載的會計師報告。閣下應結合附錄一會計師報告中所載的我們的綜合財務資料(包括相關附註)及「財務資料」一節所載的資料，一併閱讀本概要。

### 綜合損益表的選取項目

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入.....	<b>285,514</b>	<b>567,900</b>	<b>864,186</b>
銷售成本.....	(225,807)	(478,126)	(706,403)
毛利.....	<b>59,707</b>	<b>89,774</b>	<b>157,783</b>
除稅前溢利／(虧損).....	<b>(34,375)</b>	<b>(16,905)</b>	<b>26,315</b>
所得稅抵免.....	13,468	8,266	3,480
年內溢利／(虧損).....	<b><u>(20,907)</u></b>	<b><u>(8,639)</u></b>	<b><u>29,795</u></b>
歸屬於：			
母公司擁有人.....	(20,939)	(8,708)	29,792
非控股權益.....	32	69	3
	<b><u>(20,907)</u></b>	<b><u>(8,639)</u></b>	<b><u>29,795</u></b>

## 概 要

### 收入

下表載列於所示年度按業務線劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
<b>MEMS微納米製造元件</b>						
—EMI屏蔽罩.....	96,979	34.0	151,021	26.6	160,366	18.5
—精密結構件.....	94,891	33.2	93,827	16.5	180,639	20.9
—精密連接器.....	8,207	2.9	10,744	1.9	10,267	1.2
小計.....	<u>200,077</u>	<u>70.1</u>	<u>255,592</u>	<u>45.0</u>	<u>351,272</u>	<u>40.6</u>
<b>半導體測試探針</b>						
—銷釘.....	48,971	17.2	53,239	9.4	80,343	9.3
—塑膠插座.....	7,337	2.6	47,184	8.3	153,888	17.8
—其他半導體測試探針.....	1,510	0.5	17,750	3.1	23,986	2.8
小計.....	<u>57,818</u>	<u>20.3</u>	<u>118,173</u>	<u>20.8</u>	<u>258,217</u>	<u>29.9</u>
<b>微型傳動系統</b> .....	<b>4,079</b>	<b>1.4</b>	<b>154,382</b>	<b>27.2</b>	<b>185,141</b>	<b>21.4</b>
<b>其他<sup>(1)</sup></b> .....	<b>23,540</b>	<b>8.2</b>	<b>39,753</b>	<b>7.0</b>	<b>69,556</b>	<b>8.1</b>
<b>總計</b> .....	<b><u>285,514</u></b>	<b><u>100.0</u></b>	<b><u>567,900</u></b>	<b><u>100.0</u></b>	<b><u>864,186</u></b>	<b><u>100.0</u></b>

附註：

- (1) 其他主要指模具產品銷售、廢料銷售以及租金收入。於往績記錄期間，我們為提高資源回收率並踐行ESG倡議，將生產過程中產生的金屬邊角料出售予第三方。模具產品收入指向同時會購買我們主要產品的客戶銷售根據其定製訂單獲提供的客戶定製模具，主要用於回收相關設計及製造成本。於2024年4月，我們與一名第三方訂立為期兩年的租賃協議，據此，我們將部分生產設施(包括樓宇空間、機械、辦公設備及工具以及電子設備)對外出租。此為一次性安排，主要出於策略目的以促進聯合協作。該租賃將於2026年4月屆滿。因此，我們已於2024年及2025年確認租金收入。

下表載列於所示年度按地域劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
<b>亞洲</b> .....	<b>250,318</b>	<b>87.7</b>	<b>481,923</b>	<b>84.8</b>	<b>685,174</b>	<b>79.3</b>
—中國內地.....	194,207	68.1	407,506	71.7	575,173	66.6
—香港.....	14,051	4.9	11,661	2.0	10,471	1.2
—台灣.....	9,170	3.2	11,800	2.1	24,380	2.8
—其他亞洲國家.....	32,890	11.5	50,956	9.0	75,150	8.7
<b>北美</b> .....	<b>31,669</b>	<b>11.1</b>	<b>78,728</b>	<b>13.9</b>	<b>171,304</b>	<b>19.8</b>
<b>歐洲</b> .....	<b>3,527</b>	<b>1.2</b>	<b>7,249</b>	<b>1.3</b>	<b>7,708</b>	<b>0.9</b>
<b>總計</b> .....	<b><u>285,514</u></b>	<b><u>100.0</u></b>	<b><u>567,900</u></b>	<b><u>100.0</u></b>	<b><u>864,186</u></b>	<b><u>100.0</u></b>

## 概 要

### 按性質劃分的銷售成本

我們的銷售成本主要包括(i)直接材料成本；(ii)製造間接成本；(iii)人工成本；(iv)外包加工成本；及(v)存貨減值虧損。下表載列於所示年度按性質劃分的銷售成本明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
直接材料成本 .....	102,121	45.2	227,866	47.7	346,166	49.0
製造間接成本 .....	46,706	20.7	100,081	20.9	148,087	21.0
人工成本 .....	42,891	19.0	91,438	19.1	130,150	18.4
外包加工成本 .....	22,433	9.9	45,527	9.5	66,607	9.4
存貨減值虧損 .....	11,656	5.2	13,214	2.8	15,393	2.2
總計 .....	<b>225,807</b>	<b>100.0</b>	<b>478,126</b>	<b>100.0</b>	<b>706,403</b>	<b>100.0</b>

### 毛利及毛利率

於2023年、2024年及2025年，我們的毛利分別為人民幣59.7百萬元、人民幣89.8百萬元及人民幣157.8百萬元。毛利率指毛利除以收入所得結果，以百分比表示。於2023年、2024年及2025年，我們的毛利率分別為20.9%、15.8%及18.3%。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
<b>MEMS微納米製造元件</b>						
—EMI屏蔽罩 .....	24,115	24.9	42,385	28.1	49,044	30.6
—精密結構件 .....	22,862	24.1	(3,230)	(3.4)	(27,469)	(15.2)
—精密連接器 .....	2,150	26.2	1,050	9.8	3,249	31.7
小計 .....	49,127	24.6	40,205	15.7	24,824	7.1
<b>半導體測試探針</b>						
—銷釘 .....	10,822	22.1	14,460	27.2	23,262	29.0
—塑膠插座 .....	766	10.4	17,876	37.9	84,865	55.1
—其他半導體測試探針 .....	463	30.7	4,138	23.3	4,229	17.6
小計 .....	12,051	20.8	36,474	30.9	112,356	43.5
微型傳動系統 .....	(843)	(20.7)	8,109	5.3	13,545	7.3
其他 .....	(628)	(2.7)	4,986	12.5	7,058	10.1
總計 .....	<b>59,707</b>	<b>20.9</b>	<b>89,774</b>	<b>15.8</b>	<b>157,783</b>	<b>18.3</b>

我們的毛利及毛利率受多項因素影響，例如我們所銷售不同產品線的銷售結構、行業內的競爭狀況、行業週期以及經濟及政治環境等。詳情請參閱「財務資料 — 各年度的經營業績比較」。

## 概 要

### 綜合財務狀況表選取項目

下表載列我們於所示日期的綜合財務狀況表中的若干選取項目：

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
非流動資產總額.....	374,120	429,176	496,846
流動資產總額.....	1,004,259	978,892	979,047
<b>總資產.....</b>	<b>1,378,379</b>	<b>1,408,068</b>	<b>1,475,893</b>
非流動負債總額.....	16,902	14,504	13,513
流動負債總額.....	136,887	184,780	234,494
<b>總負債.....</b>	<b>153,789</b>	<b>199,284</b>	<b>248,007</b>
<b>資產淨值.....</b>	<b>1,224,590</b>	<b>1,208,784</b>	<b>1,227,886</b>
流動資產淨值.....	867,372	794,112	744,553
母公司擁有人應佔權益.....	1,224,559	1,208,679	1,227,785
非控股權益.....	31	105	101
<b>權益總額.....</b>	<b>1,224,590</b>	<b>1,208,784</b>	<b>1,227,886</b>

我們的流動資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣867.4百萬元減少至截至2024年12月31日的人民幣794.1百萬元，主要是由於(i)現金及現金等價物減少人民幣616.2百萬元；(ii)貿易及其他應付款項增加人民幣63.3百萬元；及(iii)預付款項、其他應收款項及其他資產減少人民幣28.9百萬元。其部分被以下各項所抵銷：(i)按公允價值計入損益的金融資產增加人民幣519.0百萬元；(ii)以攤餘成本計量的貿易應收款項及應收票據增加人民幣73.9百萬元；及(iii)存貨增加人民幣28.6百萬元。

我們的資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣1,224.6百萬元減少至截至2024年12月31日的人民幣1,208.8百萬元，主要受(i)確認年內虧損人民幣8.6百萬元；及(ii)宣派及派付股息人民幣7.2百萬元所推動。

我們的流動資產淨值由截至2024年12月31日的人民幣794.1百萬元減少至截至2025年12月31日的人民幣744.6百萬元，主要是由於(i)按公允價值計入損益的金融資產減少人民幣519.0百萬元；(ii)預付款項、其他應收款項及其他資產減少人民幣47.6百萬元；及(iii)貿易及其他應付款項增加人民幣31.0百萬元。其部分被以下各項所抵銷：(i)現金及現金等價物增加人民幣524.2百萬元；(ii)以攤餘成本計量的貿易應收款項及應收票據增加人民幣17.6百萬元；及(iii)按公允價值計入其他全面收益的應收票據增加人民幣14.8百萬元。

我們的資產淨值由截至2024年12月31日的人民幣1,208.8百萬元增加至截至2025年12月31日的人民幣1,227.9百萬元，主要受確認年內利潤人民幣29.8百萬元所推動，部分被宣派及派付股息人民幣9.3百萬元所抵銷。

## 概 要

### 綜合現金流量表選取項目

下表載列我們於所示年度的綜合現金流量表中的若干選取項目：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
經營活動(所用)／所得現金淨額.....	(11,056)	14,049	75,314
投資活動所得／(所用)現金淨額.....	543,145	(599,304)	459,927
融資活動(所用)／所得現金淨額.....	14,333	(30,388)	(12,418)
現金及現金等價物淨增加／(減少).....	546,422	(615,643)	522,823
年初現金及現金等價物.....	158,831	706,998	90,808
外幣業務現金流量折算匯兌差額.....	1,745	(547)	1,339
<b>年末現金及現金等價物.....</b>	<b>706,998</b>	<b>90,808</b>	<b>614,970</b>

於往績記錄期間，我們普遍錄得經營活動現金淨流入，2023年除外，該年我們錄得經營活動現金淨流出。於2023年，我們經營活動所用現金淨額為人民幣11.1百萬元，主要是由於除稅前虧損人民幣34.4百萬元，並經以下各項調整：(i)非現金及非經營項目：(a)物業、廠房及設備折舊人民幣37.0百萬元，(b)結構性存款投資收入人民幣12.2百萬元，(c)存貨減值虧損人民幣11.7百萬元，及(d)銀行利息收入人民幣10.1百萬元；及(ii)營運資金變動，主要包括(a)以攤餘成本計量的貿易應收款項及應收票據增加人民幣57.7百萬元，(b)按公允價值計入其他全面收益的應收票據減少人民幣23.2百萬元，(c)貿易及其他應付款項增加人民幣23.0百萬元，(d)存貨增加人民幣20.3百萬元，及(e)預付款項、其他應收款項及其他資產減少人民幣8.8百萬元。

更多詳情，請參閱「風險因素 — 與我們的財務表現有關的風險 — 我們過往曾錄得經營活動現金淨流出，倘未來繼續錄得經營活動現金淨流出，我們的流動性、財務狀況及前景可能會受到不利影響」及「財務資料 — 流動資金及資本資源 — 現金流量」。

## 概 要

### 主要財務比率

下表載列本公司於所示日期或所示年度的若干主要財務比率：

	截至12月31日／截至該日止年度		
	2023年	2024年	2025年
毛利率(%).....	20.9	15.8	18.3
淨利潤率(%).....	(7.3)	(1.5)	3.4
流動比率(倍).....	7.3	5.3	4.2
速動比率(倍).....	6.8	4.8	3.7
資產負債比率(%).....	2.9	1.5	2.7

有關上述比率的計算方法及分析說明，請參閱「財務資料 — 主要財務比率」。

### 競爭狀況

微納米製造行業競爭激烈且發展迅速。我們在全球範圍內與MEMS元件製造商、半導體測試探針製造商，以及其他精密微納米製造企業展開競爭，該等企業包括專業晶圓代工廠、晶圓級封裝供應商，以及具備內部生產能力的垂直整合OEM。競爭取決於多項因素，包括工藝覆蓋範圍及成熟度、良率及可靠性、生產週期及按時交貨能力、成本結構、工程技術支持及聯合研發能力、質量認證，以及知識產權及專有技術保護。儘管行業進入壁壘較高，但新產能及新進入者仍不斷出現，且部分客戶採用內部生產或雙源供應模式。詳情請參閱「行業概覽」。

### 法律程序及合規

#### 合規

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司並未涉及且目前未涉及任何重大或系統性不合規事件，而該等事件已導致罰款、執法行動或其他處罰，且不論單獨或合計而言，均可能對本公司業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

#### 法律程序

我們可能會在日常業務過程中不時涉及各類法律或行政程序。不論結果如何，訴訟或其他任何法律或行政程序均可能產生龐大費用，並分散本公司資源(包括管理層的時間及精力)。有關更多信息，請參閱「風險因素 — 與我們經營相關的風險 — 我們可能在日常業務過程中涉及索償、糾紛、訴訟、仲裁或其他法律程序。法律及監管程序的不利結果可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響」。於最後實際可行日期，並無針對本公司或本公司董事的待決或威脅提出的法律程序，且不論單獨或合計而言，該等法律程序均可能對本公司業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。詳情請參閱「業務 — 法律程序及合規」。

---

## 概 要

---

### 科創板上市

本公司A股自2021年3月起已在科創板上市(股票代碼：688661.SH)。詳情請參閱「歷史、發展及公司架構—本公司主要公司發展—科創板上市」。

[編纂]

### [編纂]開支

[編纂]的估計[編纂]開支總額(基於[編纂]最高[編纂]並假設[編纂]未獲行使)約為人民幣[編纂]元(約[編纂]港元)，包括(i)所有[編纂]的[編纂]、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費約[編纂]港元；及(ii)非[編纂]相關開支約[編纂]港元，包括(a)法律顧問及申報會計師

## 概 要

費用及開支約[編纂]港元；及(b)保薦人費用及其他費用及開支約[編纂]港元，按相同假設計佔[編纂][編纂]總額約[編纂]%

於往績記錄期間，我們產生[編纂]開支人民幣[編纂]元，其中[編纂]開支約人民幣[編纂]元([編纂]港元)作為行政開支，及約人民幣[編纂]元([編纂]港元)截至2025年12月31日自權益直接扣除。[編纂]開支剩餘估計金額人民幣[編纂]元，約人民幣[編纂]元([編纂]港元)作為行政開支，及人民幣[編纂]元([編纂]港元)預期於[編纂]後自權益直接扣除確認。

### 股息及股息政策

於往績記錄期間，我們分別於2023年、2024年及2025年宣派並派付股息人民幣14.4百萬元、人民幣7.2百萬元及人民幣9.3百萬元。根據中國適用法律法規，包括《中華人民共和國公司法》及《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅(2025年修訂)》，以及本公司章程，在符合現金股息分派條件的前提下，本公司年度現金股息分派金額應不少於本公司該年度按照中國企業會計準則計算的可供分配的歸屬於股東的利潤的10%。未來利潤分派可採取現金股息、股票股息或現金股息與股票股息相結合的形式。任何擬議的股息分派均須由本公司董事會酌情決定，並須獲本公司股東大會批准。本公司董事會在考慮本公司的經營業績、財務狀況、營運需要、資本需求、股東利益及董事會認為相關的任何其他因素後，可於未來建議分派股息。

### [編纂]用途

我們估計，在扣除與[編纂]有關而須由我們支付的[編纂]、費用及估計開支後，假設[編纂]未獲行使，且每股H股[編纂]本文件所述最高[編纂]即[編纂]港元，我們將自[編纂]收取約[編纂]港元的[編纂]。

配合我們的策略，我們目前擬將該等[編纂]用於以下用途，但會因應我們不斷變化的業務需求及市況變動而有所調整：

[編纂] 百分比	[編纂]港元計的 近似金額	未來計劃
[編纂]%	[編纂]	為下一代產品研發提供資金
[編纂]%	[編纂]	用以聘請更多專業人才，擴充我們的人才庫
[編纂]%	[編纂]	用於有選擇地收購本行業以及我們價值鏈下游的公司。

## 概 要

[編纂] 百分比	[編纂]港元計的 近似金額	未來計劃
[編纂]%	[編纂]	升級及擴展我們在國內及海外的營銷和分銷網絡，以加強我們的全球業務佈局及提升銷售執行能力。
[編纂]%	[編纂]	用作營運資金及一般企業用途

詳情請參閱「未來計劃及[編纂]」。

### 近期發展及並無重大不利變動

#### 近期發展

於2025年12月31日之後至最後實際可行日期，由於我們持續努力推進技術、拓展產品類別，以及留住和擴大高質素客戶群，業務持續增長。值得注意的是，2025年12月31日之後，我們從一家為高性能計算及先進通訊領域提供組裝及測試服務的領先供應商獲得數筆新訂單，同時與數家領先的海外及國內外包半導體封裝及測試服務供應商加強合作並提升訂單份額。

於2026年，我們在多條產品線實現產品開發里程碑。我們用於大尺寸GPU及CPU封裝芯片測試的彈性體插座產品成功完成研發並進入試產階段，關鍵性能指標達到國際先進水平。我們用於PAM4 224Gbps芯片測試的同軸彈簧探針插座進入小批量生產階段，同時我們正為CPO及高算力芯片應用開發下一代高速同軸插座產品。此外，我們用於DRAM及Flash存儲芯片的測試插座已獲得客戶認證並進入量產，所有設計及製造流程均於內部完成。

該等進展鞏固了我們在行業中的競爭地位，並為業務持續增長奠定了堅實基礎。截至最後實際可行日期，我們擁有約人民幣160.9百萬元的訂單積壓，代表已收到客戶就未來產品交付發出的採購訂單。

#### 並無重大不利變動

我們的董事確認，直至本文件日期，我們的業務模式以及所處的整體經濟和監管環境均無重大變動。自2025年12月31日（即本文件附錄一會計師報告所載本集團最近期經審計綜合財務狀況的日期）起，我們的財務或經營狀況或前景亦無重大不利變動。